

企業価値向上に向けた成長戦略について

ー産業革新機構及び事業会社8社の共同出資の受入れー

ルネサス エレクトロニクス株式会社

2012年12月10日

代表取締役社長 赤尾 泰

本日の説明内容

- 1. 産業革新機構及び事業会社8社を
割当先とする第三者割当増資について**
- 2. 将来の成長に向けた競争力強化策について**

2013年3月期 連結業績予想の修正

- 欧州の債務・金融問題の長期化、中国をはじめとする新興国経済の更なる減速、日中関係の不透明化による需要への影響などにより、通期の売上高を下方修正
- 売上減に対し、生産効率化や更なる費用削減施策を進めることにより、損益面の公表値は維持し、前回予想から変更せず

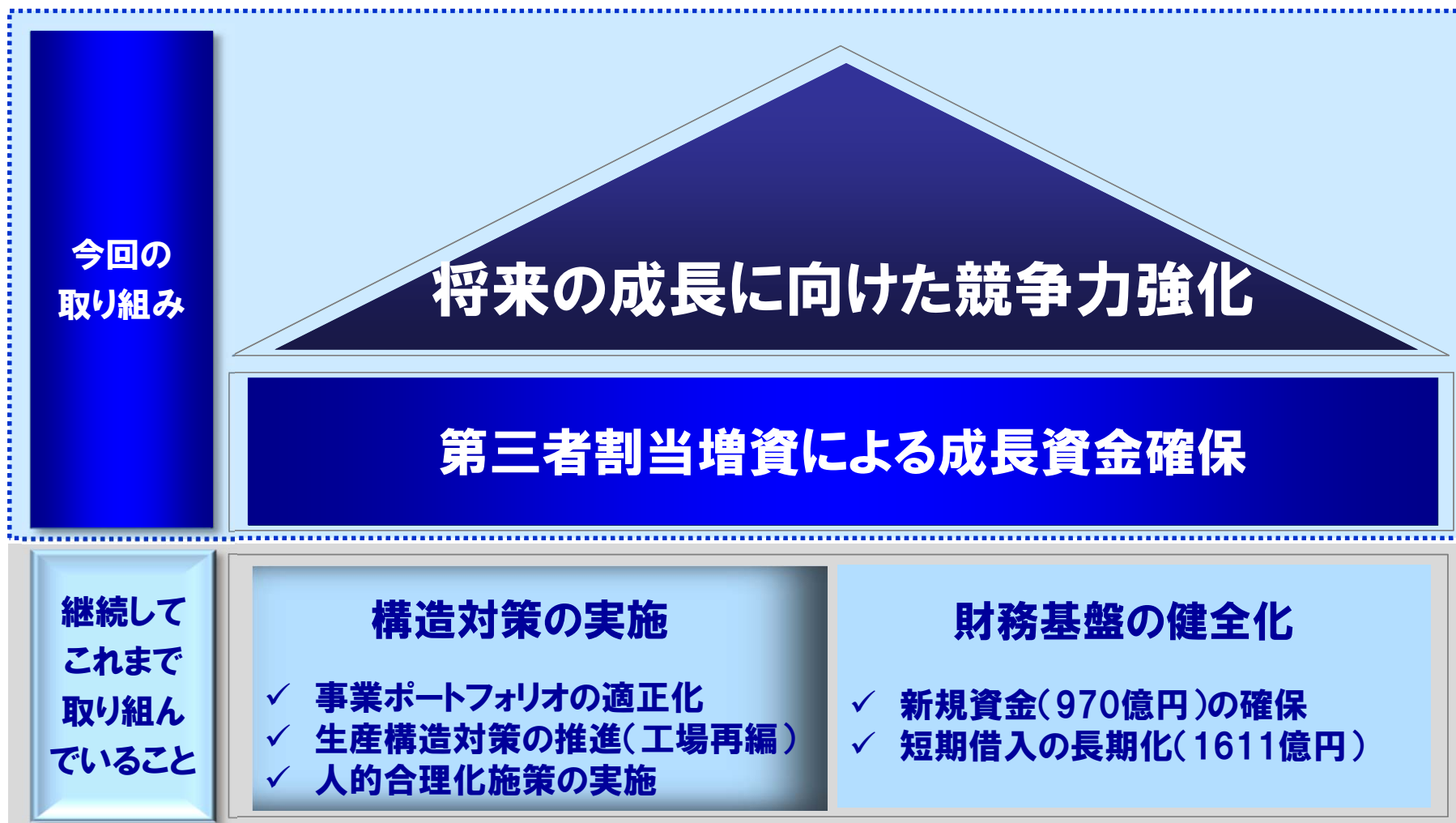
(単位:億円)	2012年3月期			2013年3月期				
	上期実績	下期実績	通期実績	上期実績	下期見通し	通期見通し	通期 前回予想(*)	前回予想比 (前期比)
売上高	4,505	4,326	8,831	4,094	4,106	8,200	8,680	△480 (△631)
半導体売上高	4,022	3,838	7,860	3,736	3,864	7,600	8,110	△510 (△260)
営業損益	△292	△276	△568	△233	443	210	210	±0 (+778)
経常損益	△333	△278	△612	△244	344	100	100	±0 (+712)
当期純損益	△420	△206	△626	△1,151	△349	△1,500	△1,500	±0 (△874)
1US\$=	81円	78円	79円	80円	81円	80円	78円	—
1ユーロ=	115円	104円	109円	102円	105円	103円	100円	—

*前回予想は8/2の第1四半期決算発表時点

産業革新機構及び事業会社8社を割当先とする 第三者割当増資について

本第三者割当増資の目的

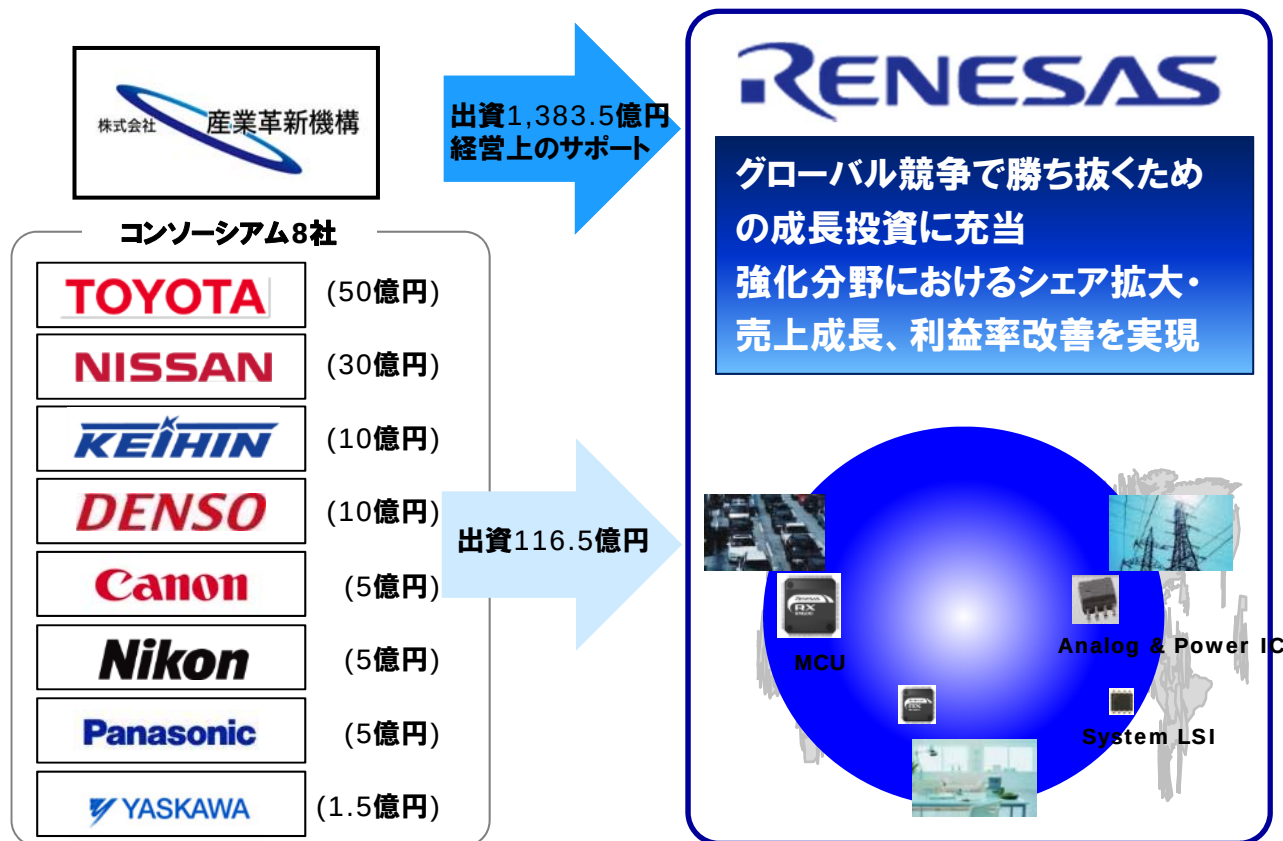
- これまでの収益基盤強化策を土台として、**将来の成長に向けた競争力強化**を狙う



本第三者割当増資の概要

- 第三者割当の方法により、産業革新機構および事業会社8社から総額1,500億円の資金を調達

本件ストラクチャー概要

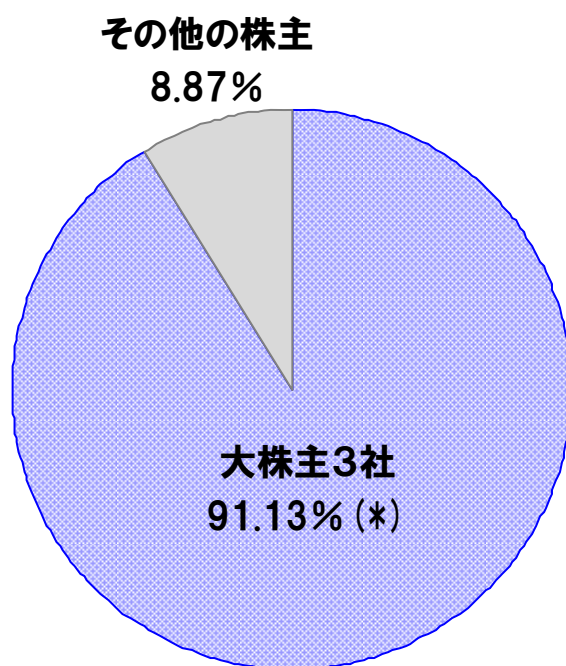


募集の概要

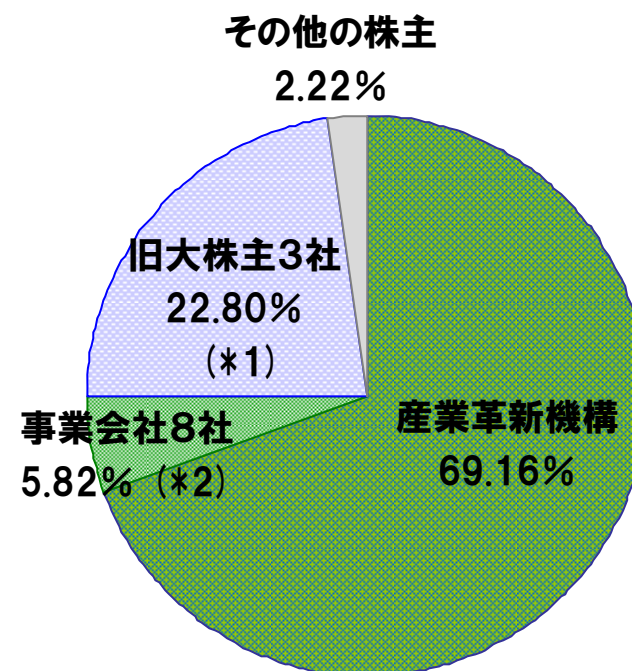
募集方法	第三者割当の方法
株式の種類	普通株式
発行新株式数	12.5億株
発行価額	1株につき120円
調達資金の額	1,500億円
払込期間	平成25年2月23日 ～同年9月30日
その他	上記の前提条件 ①臨時株主総会における関連議案の承認 ②金商法上の有価証券届出書の効力発生 ③各国関係当局の許可等の取得

本第三者割当増資後の株主構成（議決権比率）

- 本第三者割当増資に伴い、産業革新機構が当社の議決権の2/3超を保有する筆頭株主となり、事業会社8社も合計で5.82%を構成する予定
- 現大株主である3社（日本電気、日立製作所、三菱電機）の議決権比率は、各々10%を下回り、金融商品取引法上の主要株主に該当しなくなる予定



* 日本電気 (35.46%), 日立製作所 (30.62%), 三菱電機 (25.05%)



*1 日本電気 (8.87%), 日立製作所 (7.66%), 三菱電機 (6.27%)

*2 トヨタ (2.50%), 日産自動車 (1.50%), ケーヒン (0.50%)
デンソー (0.50%), キヤノン (0.25%), ニコン (0.25%)
パナソニック (0.25%), 安川電機 (0.07%)

資金調達の必要性・本第三者割当増資の選定理由

- 非周期的かつ急激な市況変化に耐えうる財務基盤の確立、業績の回復に向けた研究開発、設備投資、M&A等の成長投資を行う必要性が日増しに高まる

- 上記の財務基盤強化、成長投資を実現する資金充実の方法として、追加借入、公募増資、ライツオフリング、第三者割当増資を検討
- 第三者割当増資の中でも、国内外の複数の候補先からの提案・条件を比較検討

- 当社顧客とのコンソーシアム組成を前提とした産業革新機構からの提案が、当社が必要とする多額の資金を一括して確実に迅速に調達できる点、割当予定先との事業シナジーの面で優れていた点等を総合的に勘案
- 中長期的な観点から、当社の企業価値・株主価値の向上に最も資するスキームとして、産業革新機構をはじめとする割当予定先への第三者割当増資を決定

成長分野への投資(主な資金の使途)

第三者割当増資 1,500億円

将来の成長に向けた競争力強化

コアコンピタンスの強化

研究開発投資
400億円

設備投資
200億円

- マイコン
- ✓28nm開発・試作向け設備投資
- ✓40nmプロセス効率化開発
- ✓内蔵メモリ共同開発投資
- アナログ&パワー半導体
- ✓大口径化(12インチ)
- ✓90nmプロセス向け設備投資

ソリューション提案力の強化

自動車向けソリューション
400億円

産業向けソリューション
400億円

- パワー半導体モジュール技術の強化
- アナログIPのラインアップ拡充向けM&A等
- 組込みOS拡充向けM&A等
- 機電一体ビジネス強化向けM&A等
- 次世代車載向け開発加速
- 新興国市場向けソリューションマーケティング強化

急激な市場変化に対する耐性強化

経営基盤再構築
100億円

- 事業評価システム改善
- BCP(事業継続計画)の強化
- ✓生産設備の耐震強化
- ✓マルチファブ化

将来の成長に向けた競争力強化策について

将来の成長に向けた3つの柱

1. コアコンピタンスの強化
2. ソリューション提案力の強化
3. 急激な市場変化に対する耐性強化



マイコン、アナログ&パワー半導体を合わせ
スマート社会におけるプラットフォーム・リーダーへ

事業モデルの将来像（求められる姿）

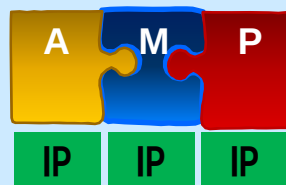
→ スマート社会

プロダクト サプライヤー

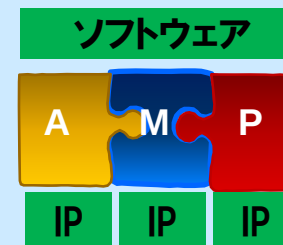
アナログ
(センシング) マイコン
(制御) パワー
(駆動)



キットソリューション
サプライヤー



プラットフォーム
サプライヤー



個別製品の提案型
ビジネスモデル

マイコンを軸とした、
キットソリューション
提案型ビジネスモデル

マイコンを軸とした
プラットフォーム
提案型ビジネスモデル

ソフト等を含めたトータルソリューション展開

ラインアップの強化によるキットソリューションの展開加速

個別製品の研究開発・設備投資による競争力強化

売上増

当社の考えるキットソリューションとは

- 各システムに最適なアナログ(センシング)、マイコン(制御)、パワー(駆動)を「キットソリューション」として提供

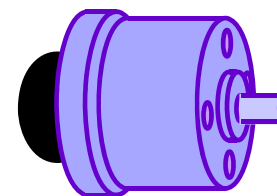
アナログ
(センシング)



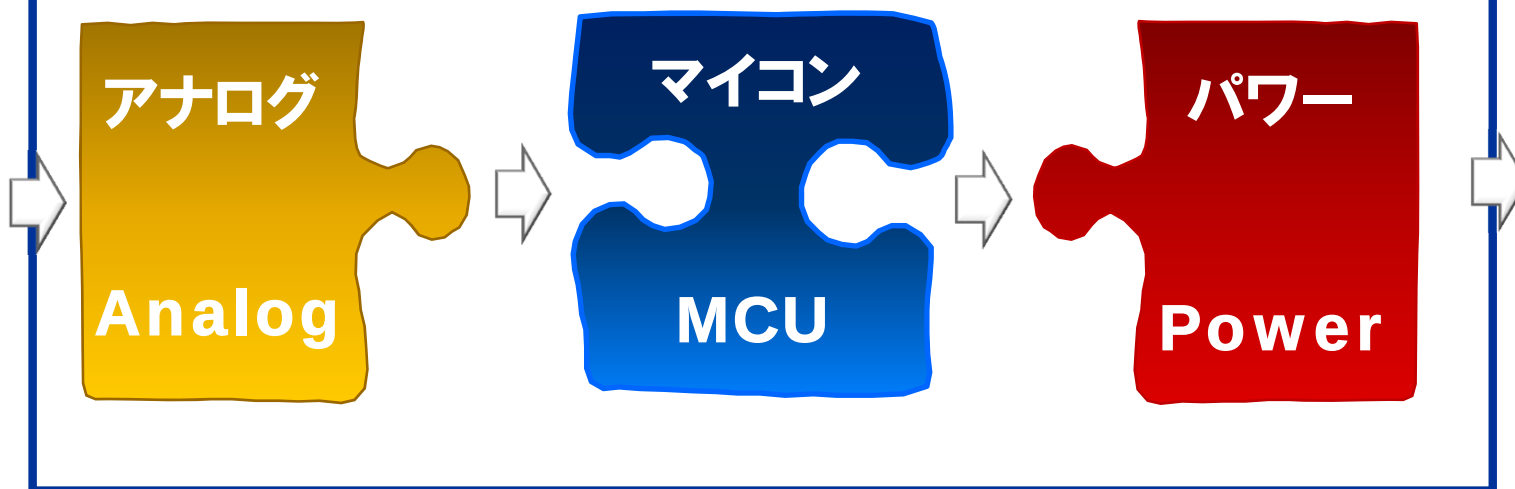
マイコン
(制御)



パワー
(駆動)

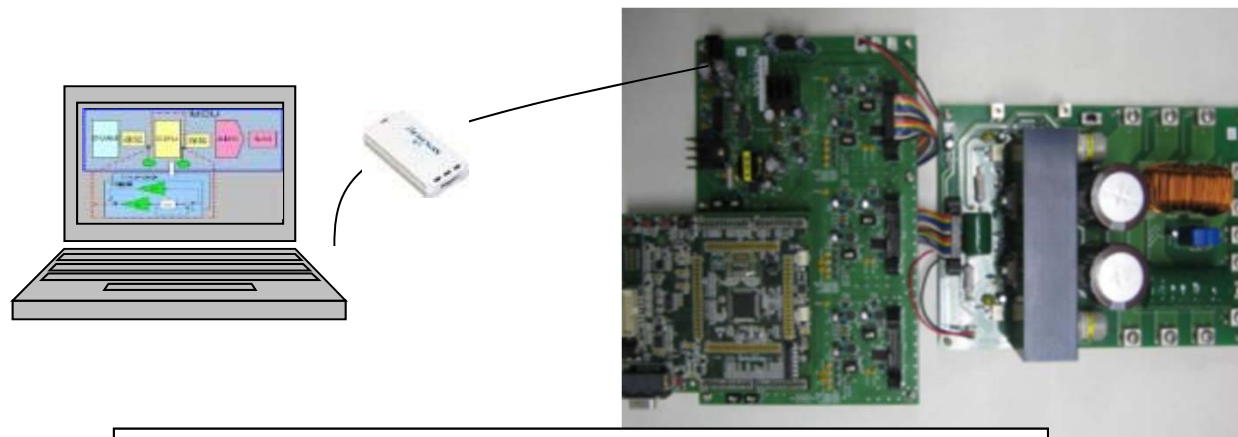


マイコン制御のキットソリューションのイメージ

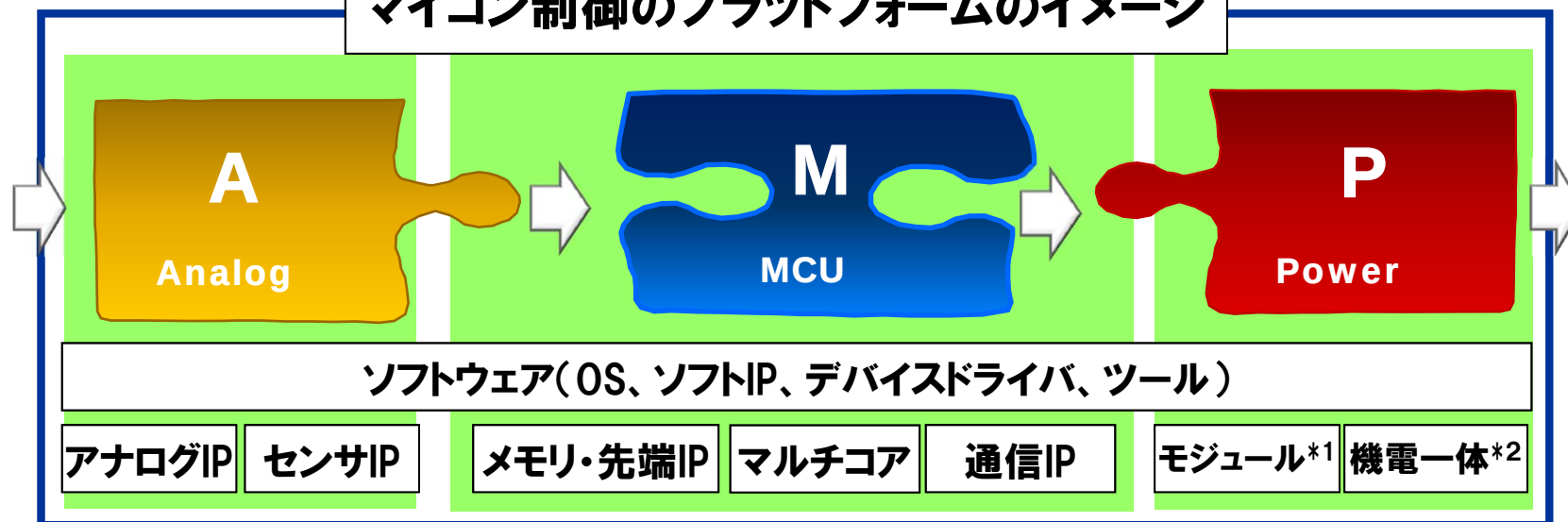


当社の考えるプラットフォームとは

- 「キットソリューション」にソフトウェア等を加え、トータルシステムとして各システムに最適な「プラットフォーム」を今後提供



マイコン制御のプラットフォームのイメージ



*1)システムを構成する要素として、ひとまとまりの機能を持った部品群 *2)機械技術と電気電子技術を融合し、機能の向上を図ること

将来の成長に向けた競争力強化について

1. コアコンピタンスの強化

将来の成長に向けた競争力強化

コアコンピタンスの強化

研究開発投資

400億円

設備投資

200億円

➤マイコン

- ✓28nm開発・試作向け設備投資
- ✓40nmプロセス効率化開発
- ✓内蔵メモリ共同開発投資
- アナログ&パワー半導体
- ✓大口径化(12インチ)
- ✓90nmプロセス向け設備投資

ソリューション提案力の強化

自動車向けソリューション

400億円

産業向けソリューション

400億円

- パワー半導体モジュール技術の強化
- アナログIPのラインアップ拡充向けM&A等
- 組込みOS拡充向けM&A等
- 機電一体ビジネス強化向けM&A等
- 次世代車載向け開発加速
- 新興国市場向けソリューションマーケティング強化

急激な市場変化に対する耐性強化

経営基盤再構築

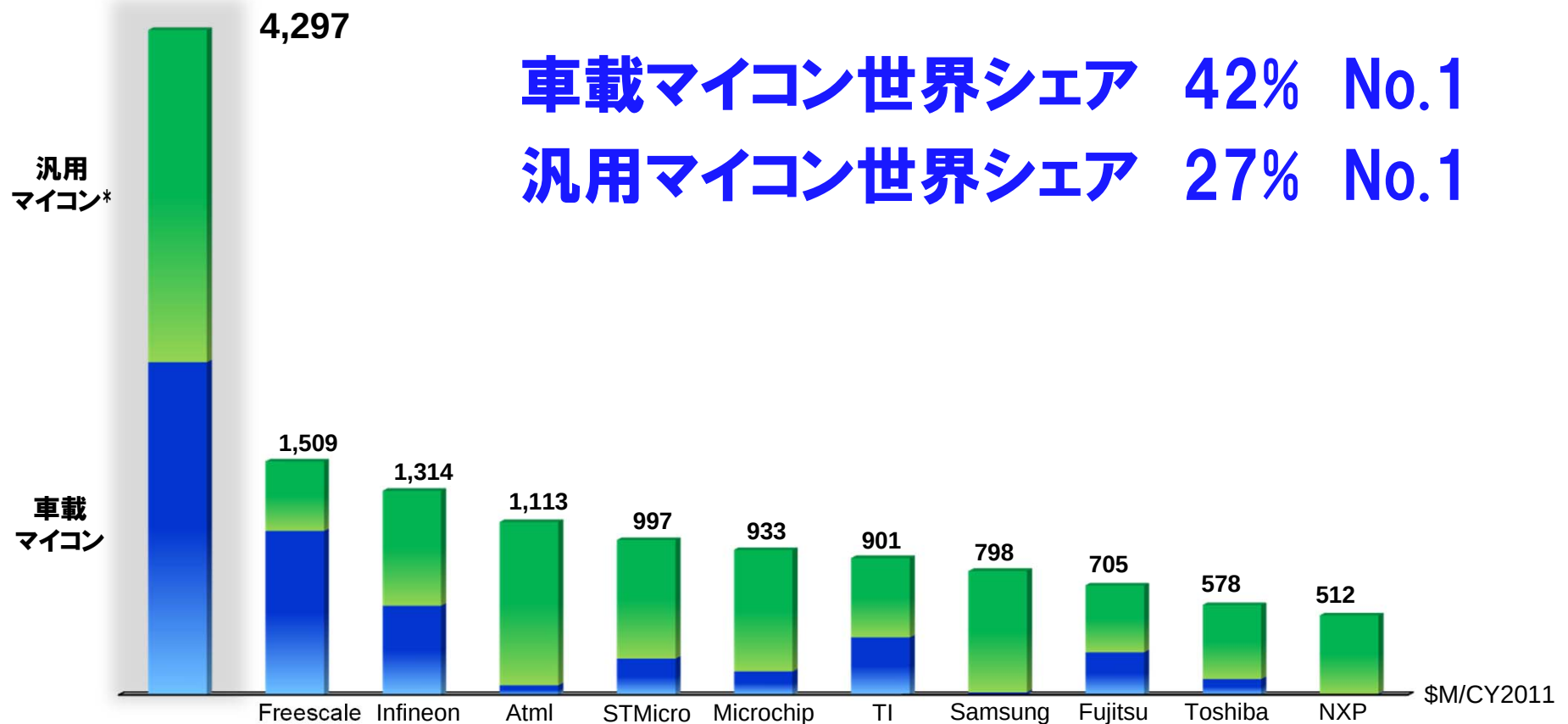
100億円

- 事業評価システム改善
- BCP(事業継続計画)の強化
- ✓生産設備の耐震強化
- ✓マルチファブ化

マイコン分野において圧倒的な優位を保持

- 最先端の技術力により、マイコン分野で世界シェアNo.1を堅持

RENESAS



*車載向けマイコン売上を除く、その他アプリケーション向けマイコン市場

出典: IHS iSuppli Competitive Landscaping Tool (CLT)

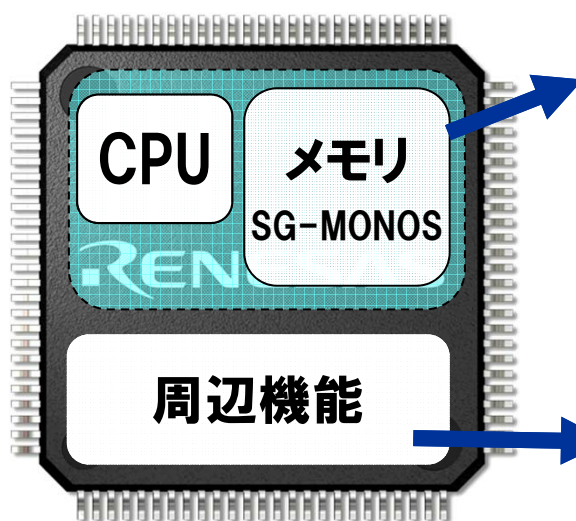
マイコンを軸に新たな市場創出

- スマート社会に向け制御(マイコン)とIT(MPU/SoC)の融合が加速



コアコンピタンス(マイコン)の強化策

マイコン概要図



圧倒的
NO.1へ

プロセス微細化で先行

➤ 先端プロセス開発・設備投資(40/28nm)

スマート社会を実現する制御とITの融合に必須な技術へ対応

- ✓ソフトウェア処理の爆発への対応
- ✓制御ハードウェアの複雑化への対応

周辺機能の圧倒的な品揃え

➤ 巨大IP資産の構築

RENESAS

No.1

トップマイコンサプライヤー
豊富な制御系IP



No.1

トップファウンドリ
豊富なIT系IP

コアコンピタンスの強化でマイコンを新たな高みへ

過去

現在

スマート社会

マイコン世界シェア No.1
(全分野・全製品群)

RENESAS



安心・安全、
エコ、便利・快適が
求められる社会

高安全性

高信頼性

低電力

高性能

高集積

自動車の例

自動走行
新セーフティシステム
CO2大幅削減



急増するソフトウェア
大容量内蔵メモリ
フェールセーフ回路

150nm

90nm

40nm
世界初の技術確立

次世代 28nm 開発

大容量内蔵
メモリ(SG-MONOS)

マルチコア

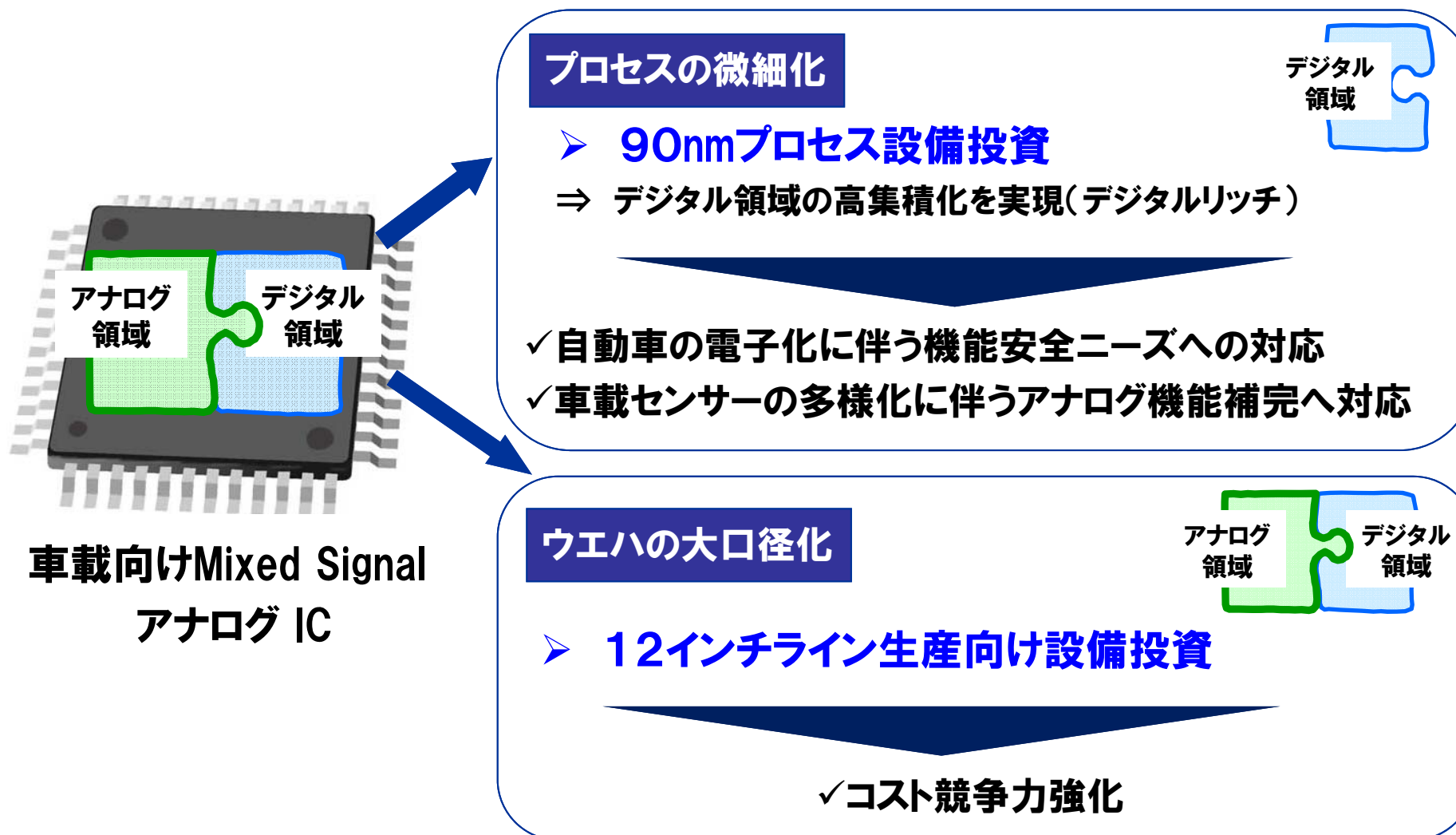
低電力

高信頼性

協業推進

アナログ製品の競争力強化策

■ 車載向けアナログ製品における微細化および大口径化の推進により市場を牽引

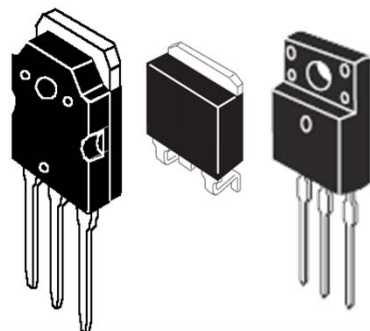


パワー製品の競争力強化策

■ 高圧製品の新材料による製品力強化およびモジュール化によるポテンシャル市場の拡大

600V以上(高圧)

IGBT・高圧パワーMOS



150V以下(低圧)

低圧パワーMOS

No.1



出典:
マーケティングアイ

新材料 (Beyond the Silicon)

➤ 次世代材料(SiC, GaN)展開促進

✓ 高効率化推進による製品競争力強化

SiC

GaN



モジュール化

➤ パワー半導体モジュール技術の強化

✓ IGBTのモジュール化によるポテンシャル市場の拡大



競合 メーカ	高圧 パワー	モジュール パッケージ	PFC 制御IC	絶縁素子 (カブラ)	マイコン
A社	○	○	×	×	×
B社	○	○	○	×	○
C社	○	○	×	○	○
ルネサス	○	×	○	○	○

将来の成長に向けた競争力強化について

2. ソリューション提案力の強化

将来の成長に向けた競争力強化

コアコンピタンスの強化

研究開発投資
400億円

設備投資
200億円

- マイコン
 - ✓ 28nm開発・試作向け設備投資
 - ✓ 40nmプロセス効率化開発
 - ✓ 内蔵メモリ共同開発投資
- アナログ & パワー半導体
 - ✓ 大口径化(12インチ)
 - ✓ 90nmプロセス向け設備投資

ソリューション提案力の強化

自動車向けソリューション
400億円

産業向けソリューション
400億円

- パワー半導体モジュール技術の強化
- アナログIPのラインアップ拡充向けM&A等
- 組込みOS拡充向けM&A等
- 機電一体ビジネス強化向けM&A等
- 次世代車載向け開発加速
- 新興国市場向けソリューションマーケティング強化

急激な市場変化に
対する耐性強化

経営基盤再構築
100億円

- 事業評価システム改善
- BCP(事業継続計画)の強化
- ✓ 生産設備の耐震強化
- ✓ マルチファブ化

スマート社会の実現を加速するルネサスのソリューション

■ ソリューション力で半導体イノベーションを社会イノベーションへ繋ぐ

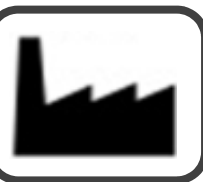
スマート社会

次世代自動車
電力網、エコハウス…

自動車



インダストリアル



コミュニケーション



ヘルスケア



ホーム



システム

EV/HEV、モータ制御
エコ家電、スマートメータ
センサネットワーク…

システムに合わせたソリューション提供



半導体

低電力マイコン
アナログ・パワー …

マイコン

No.1

No.1

車載マイコン、モータマイコン
スマートアナログ、セキュアマイコン

アナログ

車載アナログ
LEDドライバ、電池制御IC

パワー

No.1

低圧ハワ-MOS
IGBT, SiC, カプラ

SoC

No.1

No.1

産業用ASIC
LTEモデム、車載情報SoC

RENESAS

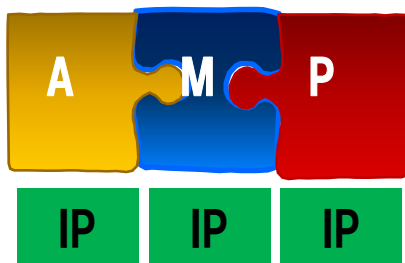
*) シェアは当社推定

自動車向けソリューション提案力の強化

自動車



ソフトウェア



ソリューション提案力強化

IP

ソフトウェア
(アプリケーション)

- センサー技術・アナログIPラインアップの拡充
- 機電一体技術*の強化

✓ M&A等による技術・事業の獲得⇒タイムリーに事業展開

先進技術への開発投資による先行

IP

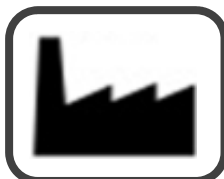
- 先進運転支援システムの実用化に向けた開発投資
- 先進技術力強化のための開発リソースの確保

✓ 当社得意の高品質・高信頼性で実用に向け業界牽引

*)機械技術と電気電子技術を融合し、機能の向上を図ること

産業向けソリューション提案力の強化

インダストリアル



コミュニケーション



ヘルスケア



ホーム



ソフトウェア



IP

IP

IP

ソリューション提案力の強化

- モジュール技術の強化
- 組み込みOS技術の強化

ソフトウェア(OS)



✓ プラットフォームビジネス展開ドメインの拡大

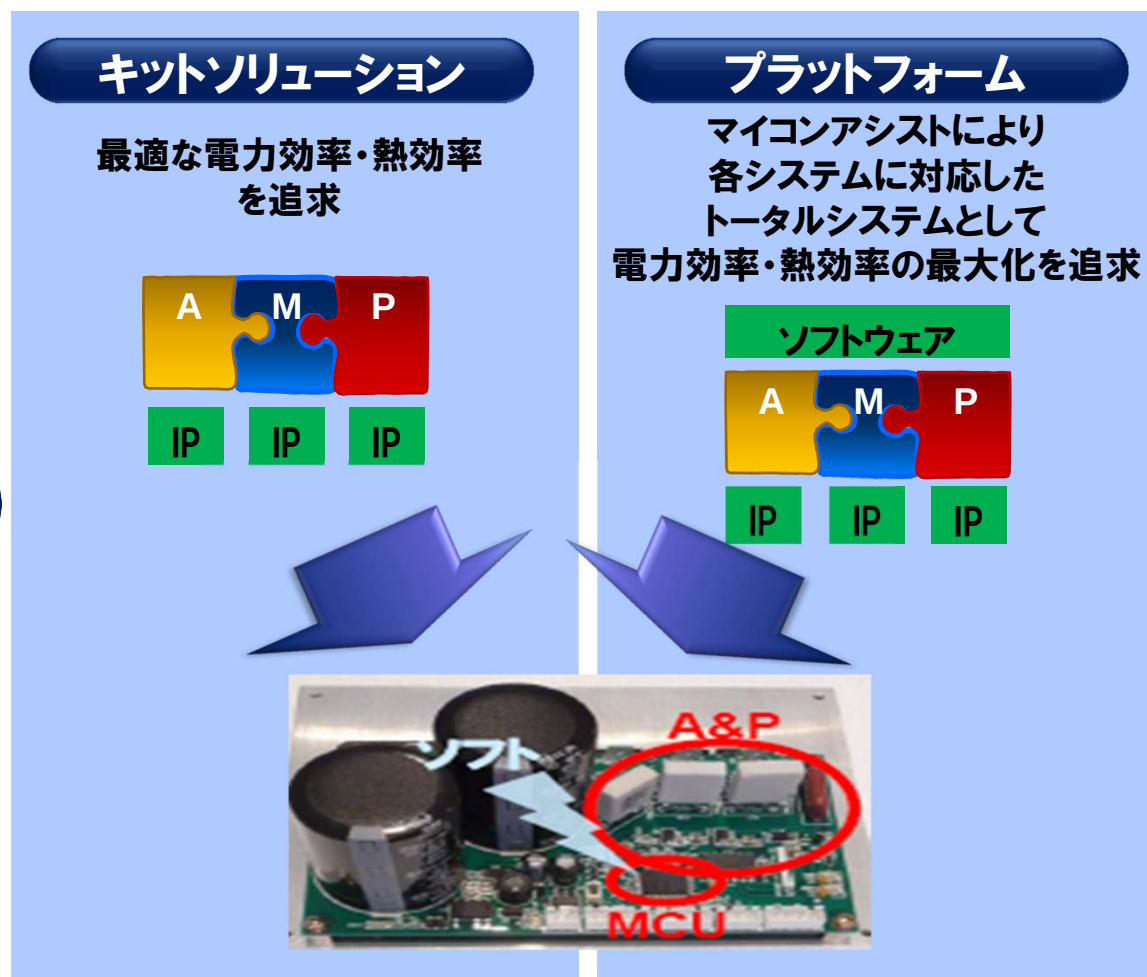
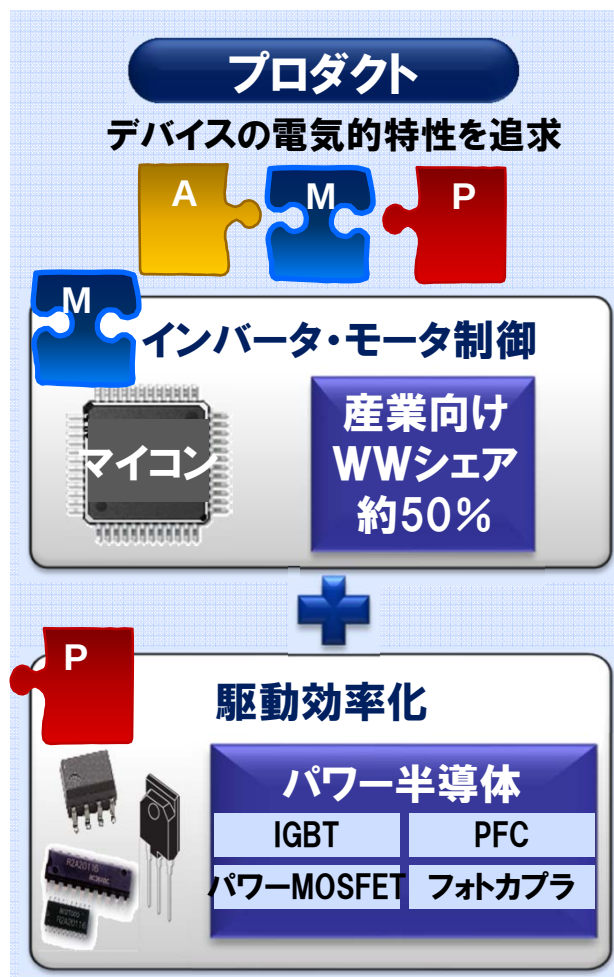
ロジスティクス含めたマーケティング強化

- 新興国の独立系デザインハウスとの協業やM&A等
- eコマースシステムの強化及び顧客サービスの拡充

✓ 新興国を中心とした成長市場での売上拡大

プラットフォームビジネスの事例(1): インバータ・モータ

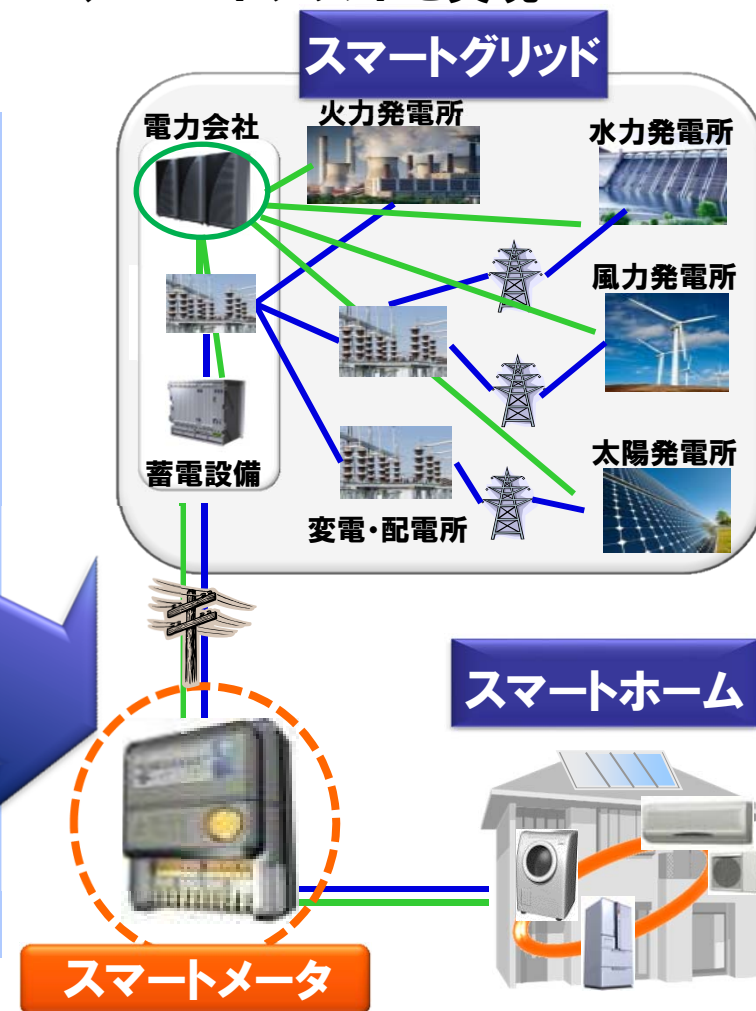
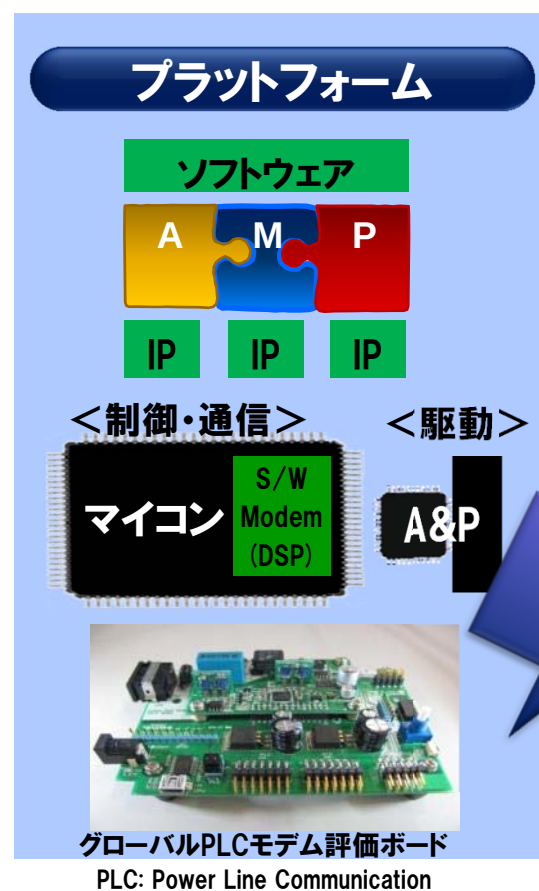
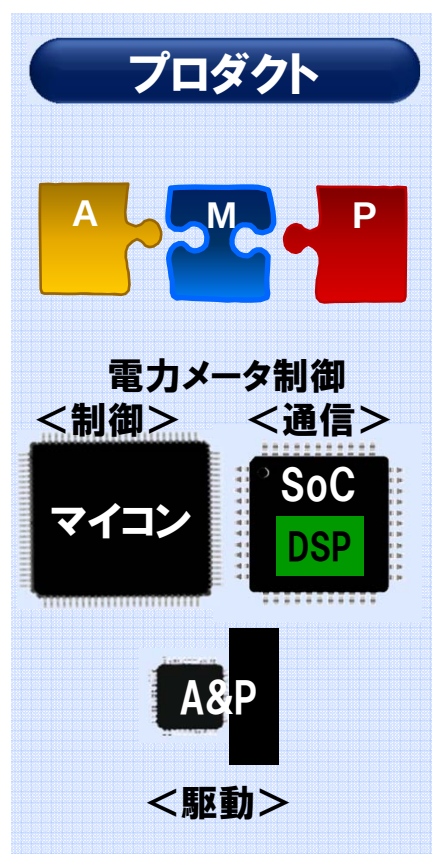
- インバータ制御におけるマイコンの優位性を強みに、マイコンとパワー半導体にソフトウェアを組み合わせ、省エネ化に最適なインバータ・モータ向けプラットフォームを提供



*) シェアは当社推定, IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor, PFC: Power Factor Correction

プラットフォームビジネスの事例(2):スマートメータ

- マイコンを軸に最適な半導体を組み合わせて、世界各地の通信規格・ニーズに対応可能なソフトウェアを搭載したプラットフォームを提供
- 制御と通信(IT)の融合を図ることで、スマートホーム、スマートグリッドを実現



プラットフォームサプライヤーを目指して



将来の成長に向けた競争力強化について

3. 急激な市場変化に対する耐性強化

将来の成長に向けた競争力強化

コアコンピタンスの強化

研究開発投資

400億円

設備投資

200億円

- マイコン
 - ✓28nm開発・試作向け設備投資
 - ✓40nmプロセス効率化開発
 - ✓内蔵メモリ共同開発投資
- アナログ&パワー半導体
 - ✓大口径化(12インチ)
 - ✓90nmプロセス向け設備投資

ソリューション提案力の強化

自動車向けソリューション

400億円

産業向けソリューション

400億円

- パワー半導体モジュール技術の強化
- アナログIPのラインアップ拡充向けM&A等
- 組込みOS拡充向けM&A等
- 機電一体ビジネス強化向けM&A等
- 次世代車載向け開発加速
- 新興国市場向けソリューションマーケティング強化

急激な市場変化に 対する耐性強化

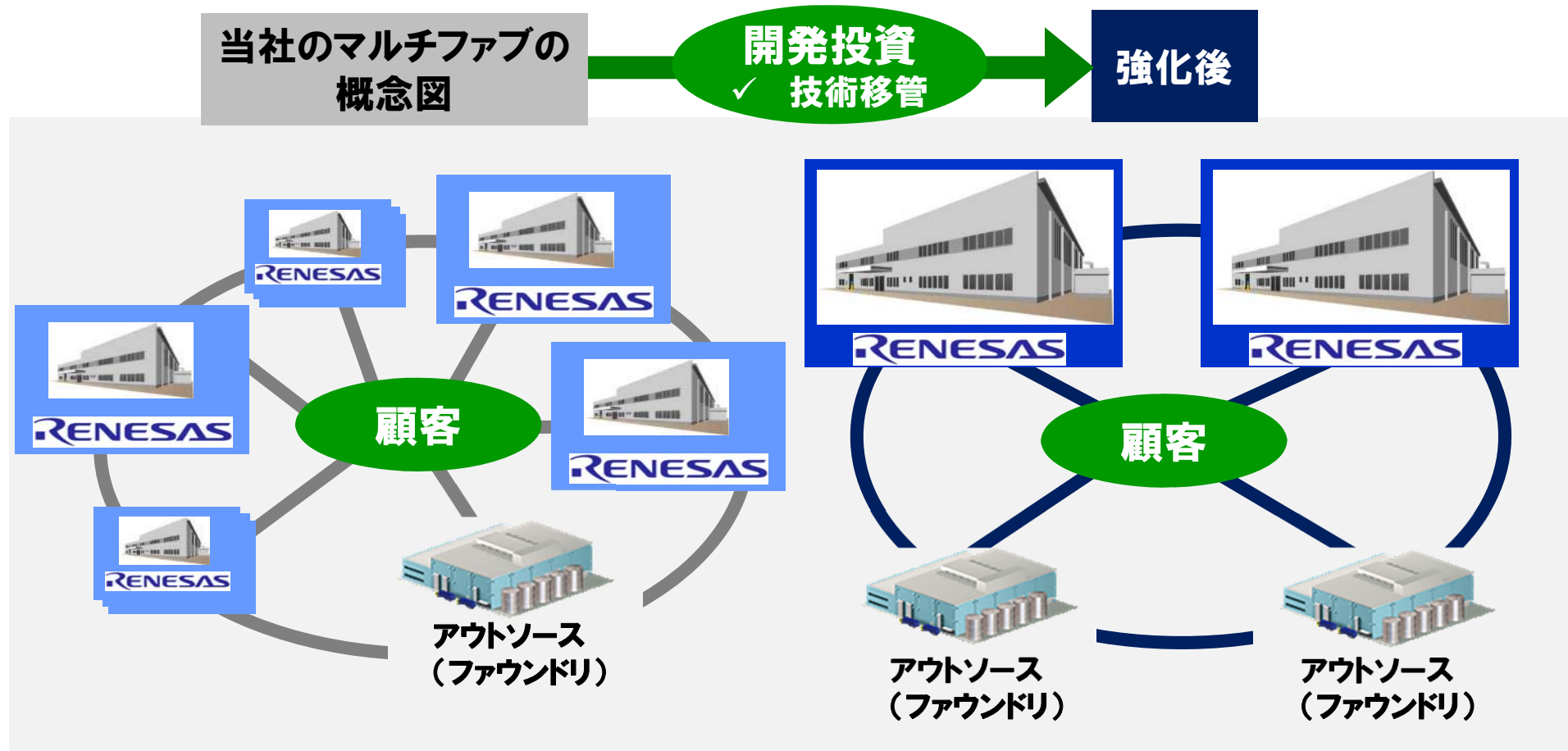
経営基盤再構築

100億円

- 事業評価システム改善
- BCP(事業継続計画)の強化
- ✓生産設備の耐震強化
- ✓マルチファブ化

更なる安定供給体制の構築・強化

- 今後生産の主力となる90・40nm世代においても大手ファウンドリを含むマルチファブ化を実現し、安心・安全な安定供給体制を強化



まとめ

まとめ

- ✓ これまでの収益基盤強化策に加え、本第三者割当増資の資金を活用することにより、将来の成長に向けた競争力強化を図ります。
- ✓ マイコンの強みを更に高め、これを軸にアナログ＆パワー半導体のキットソリューション並びにプラットフォームソリューションを構築します。
- ✓ スマート社会において付加価値の高いこれらソリューションを安定的に提供することで、売上・利益の向上を目指します。